

BC856 ... BC860 **SMD General Purpose PNP Transistors SMD Universal-PNP-Transistoren**

= -100 mA $h_{FE} \sim 180/290/520$

 $T_{jmax} = 150$ °C

 $V_{CEO} = -30...-65 \text{ V}$ $P_{tot} = 250 \text{ mW}$

Besonderheiten

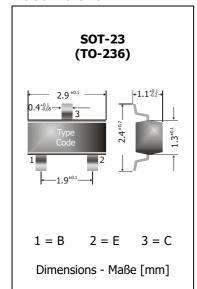
Universell anwendbar

Konfliktmineralien 1)

Drei Stromverstärkungsklassen

Konform zu RoHS, REACH,

Version 2018-10-11



Typical Applications Typische Anwendungen Signal processing, Signalverarbeitung, Switching, Amplification Schalten, Verstärken Commercial grade Standardausführung Suffix -Q: AEC-Q101 compliant 1) Suffix -Q: AEC-Q101 konform 1) Suffix -AQ: in AEC-Q101 Qualifikation 1) Suffix -AQ: in AEC-Q101 qualification 1)

Features General Purpose Three current gain groups Compliant to RoHS, REACH, Conflict Minerals 1)

Mechanical Data 1)

Mechanische Daten 1) Gegurtet auf Rolle Taped and reeled 3000 / 7" Weight approx. 0.01 gGewicht ca. Case material UL 94V-0 Gehäusematerial Solder & assembly conditions 260°C/10s Löt- und Einbaubedingungen MSL = 1

		Type Code			Recomm. complementary NPN transistors Empf. komplementäre NPN-Transistoren
BC856A/-Q BC856B/-AQ BC856C/-AQ	3A 3B 3C	BC857A/-AQ 3E BC857B/-Q/-AQ 3F BC857C/-AQ 3G BC860B 3F BC860C 3G/4G	BC858A/-AQ BC858B/-AQ BC858C/-AQ BC859A/-AQ BC859B/-AQ BC859C/-AQ	3E 3F 3G 3E 3F 3G/4G	BC846 BC850

Maximum ratings 2) Grenzwerte²)

			BC856	BC857 BC860	BC858 BC859
Collector-Emitter-volt. – Kollektor-Emitter-Spannung	B open	- V _{CEO}	65 V	45 V	30 V
Collector-Base-voltage – Kollektor-Basis-Spannung	E open	- V _{CBO}	80 V	50 V	30 V
Emitter-Base-voltage – Emitter-Basis-Spannung	C open	- V _{EBO}	5 V		
Power dissipation – Verlustleistung		P _{tot}		250 mW ³)	
Collector current – Kollektorstrom	DC	- I _C		100 mA	
Peak Collector current – Kollektor-Spitzenstrom		- I _{CM}		200 mA	
Junction temperature – Sperrschichttemperatur Storage temperature – Lagerungstemperatur		T _j	-55+150°C -55+150°C		

Please note the <u>detailed information on our website</u> or at the beginning of the data book Bitte beachten Sie die detaillierten Hinweise auf unserer Internetseite bzw. am Anfang des Datenbuches

 T_A = 25°C unless otherwise specified – T_A = 25°C wenn nicht anders angegeben

Mounted on P.C. board with 3 mm² copper pad at each terminal Montage auf Leiterplatte mit 3 mm² Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss



Characteristics Kennwerte

		T _j	= 25°C	Min.	Тур.	Max.
DC current gain – I	Kollektor-Basis-Stromverhältnis					
$-V_{CE} = 5 V$	- I _C = 10 μA	Group A Group B Group C	h _{FE}	- - -	90 150 270	- - -
	$- I_C = 2 \text{ mA}$	Group A Group B Group C	h _{FE}	125 220 420	180 290 520	250 475 800
Collector-Emitter sa	aturation voltage – Kollektor-Sä	attigungsspannung ¹)				
$\begin{array}{l} \text{- } I_{\text{C}} = 10 \text{ mA} \\ \text{- } I_{\text{C}} = 100 \text{ mA} \end{array}$	- I_B = 0.5 mA - I_B = 5 mA		- V _{CEsat}	- -	- -	300 mV 650 mV
Base-Emitter satura	ation voltage – Basis-Sättigung					
$\begin{array}{l} \text{- } I_{\text{C}} = 10 \text{ mA} \\ \text{- } I_{\text{C}} = 100 \text{ mA} \end{array}$	- I_B = 0.5 mA - I_B = 5 mA		- V _{BEsat}	_ _	700 mV 900 mV	_ _
Base-Emitter-voltage	ge – Basis-Emitter-Spannung ²)					
$- V_{CE} = 5 V$ $- V_{CE} = 5 V$	- I_C = - 2 mA - I_C = - 10 mA		- V _{BE}	600 mV –	- -	750 mV 820 mV
Collector-Base cuto	off current – Kollektor-Basis-Re	ststrom				
$- V_{CE} = 30 V$ $- V_{CE} = 30 V$	$T_j = 125$ °C	E open	- I _{CBO}	_ _	_ _	15 nA 4 μA
Emitter-Base cutoff	f current					
- V _{EB} = 5 V		C open	- I _{EBO}	_	_	100 nA
Gain-Bandwidth Pr	oduct – Transitfrequenz					
- V_{CE} = 5 V, - I_C = 10 mA, f = 100 MHz			f⊤	100 MHz	_	_
Collector-Base Cap						
- V_{CB} = 10 V, I_E = i_e = 0, f = 1 MHz			C _{CBO}	_	4.5 pF	_
Emitter-Base Capacitance – Emitter-Basis-Kapazität						
- $V_{EB} = 0.5 \text{ V}$, $I_C = i_C = 0$, $f = 1 \text{ MHz}$				_	9 pF	_
Noise figure – Raus	schzahl					
$-V_{CE} = 5 V, -I_{C}$ $R_{G} = 2 k\Omega, f =$: = 200 μA 1 kHz, Δf = 200 Hz	BC856 BC858 BC859 BC860	F	<u>-</u> -	2 dB 1.2 dB	10 dB 4 dB
Typical thermal resistance junction to ambient Typischer Wärmewiderstand Sperrschicht – Umgebung			R _{thA}	< 420 K/W ²)		

Disclaimer: See data book page 2 or <u>website</u> **Haftungssauschluss:** Siehe Datenbuch Seite 2 oder <u>Internet</u>

2 http://www.diotec.com/ © Diotec Semiconductor AG

Tested with pulses t_p = 300 μ s, duty cycle \leq 2% - Gemessen mit Impulsen t_p = 300 μ s, Schaltverhältnis \leq 2%

Mounted on P.C. board with 3 mm² copper pad at each terminal Montage auf Leiterplatte mit 3 mm² Kupferbelag (Lötpad) an jedem Anschluss